

判決年月日	平成 19 年 7 月 12 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成18年（行ケ）第10251号		
○ 名称を「実装用基板及びプリント回路板の製造方法」とする発明に関し，進歩性を欠くとした審決の判断が誤りであるとして，当該審決が取り消された事例			

（関連条文）特許法 29 条 2 項

本件は，名称を「実装用基板及びプリント回路板の製造方法」とする発明（以下「本願発明」という。）に係る特許出願につき，特許庁が拒絶査定をし，その後の不服審判請求に対しても，請求不成立の審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。

本願発明は，「金属材料からなる枠部と，前記枠部を含む前記金属材料からなる母板から打ち抜かれ，かつ，元の穴にはめ込まれたプッシュバック板からなるプリント回路板と，前記プリント回路板の接線上又はその近傍に形成され，かつ，前記枠部の外周に連通している 1 又は 2 以上の第 1 V カットと，少なくとも 1 つの前記第 1 V カットの少なくとも一部分に充填された第 1 充填材とを備えた実装用基板。」というものである。

審決は，本願発明と刊行物 1（以下「引用例 1」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）とを対比し，「本願発明は，「少なくとも 1 つの前記第 1 V カットの少なくとも一部分に充填された第 1 充填材」を備えているのに対して，引用発明はそのような構成を備えていない点。」を相違点 B として認定した上，当該相違点について，「刊行物 2（以下「引用例 2」という。）には，プッシュバックライン，すなわちプッシュバック法によって仮止めされたプリント回路板の周囲に，接着剤などを用いて仮止めを補強することが記載されている。そして，プッシュバック法により打ち抜いた部材の仮止めのために，該部材の周囲に形成される溝やスリットに接着剤を充填することも周知の技術であることに鑑みれば（例えば，刊行物 3 及び 4 参照），引用発明において，プリント回路板の共通接線上に形成された，打ち抜かれたプリント回路板の周囲の一部を含む第 1 V カットに上記引用例 2 記載の構成を適用して，本願発明の相違点 B に係る構成のようになったことは，当業者の容易に想到し得たことである。」との判断をし，本願発明は，引用発明及び引用例 2 記載の発明並びに各周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした。

本判決は，次の理由により，相違点 B についての上記審決の判断に誤りがあるとして，審決を取り消した。

「引用例 2 に記載された発明において，仮止め部又は補強部は，基板フレームが，プッシュバック法により打ち抜かれた配線基板を保持する力を強化することを目的として，形

成されるものであるところ，引用発明は，従来技術において，枠部（基板フレーム）がプリント回路板（配線基板）を保持する力が小さく，自動実装時にプリント回路板の脱落事故が発生することを解決すべき問題の一つとし，引用例１に記載された構成を採用することにより，プリント回路板が，枠部によって強力に保持されるものとした実装用基板であるから，引用発明には，この上更に，枠部が回路板を保持する力を強化することを目的として，引用例２の記載に係る，接着剤などを用いた仮止め部又は補強部を適用する必要があるとは認められない。また，確かに，刊行物３及び４には，プッシュバック法等により打ち抜いた部材の周囲に形成される溝やスリットに接着剤を充填することが記載されているが，それらの接着剤の充填は，当該部材の仮止めのため，すなわち，当該部材を枠部に保持する力を確保するためになされるものであって，その目的は，引用例２記載の発明と変わらないから，仮に，プッシュバック法等により打ち抜いた部材の周囲に形成される溝やスリットに接着剤を充填することが周知技術であるとしても，その周知技術により，引用例２記載の仮止め部又は補強部を引用発明に適用することが導かれるものでもない。

そうすると，引用発明において，プリント回路板の共通接線上に形成された，打ち抜かれたプリント回路板の周囲の一部を含む第１Ｖカットに，引用例２記載の，プリント回路板の周囲に接着剤などを用いて仮止めを補強する構成を適用することは，当業者が容易に想到し得たものと認めることはできず，審決の上記判断は誤りであるといわざるを得ない。」